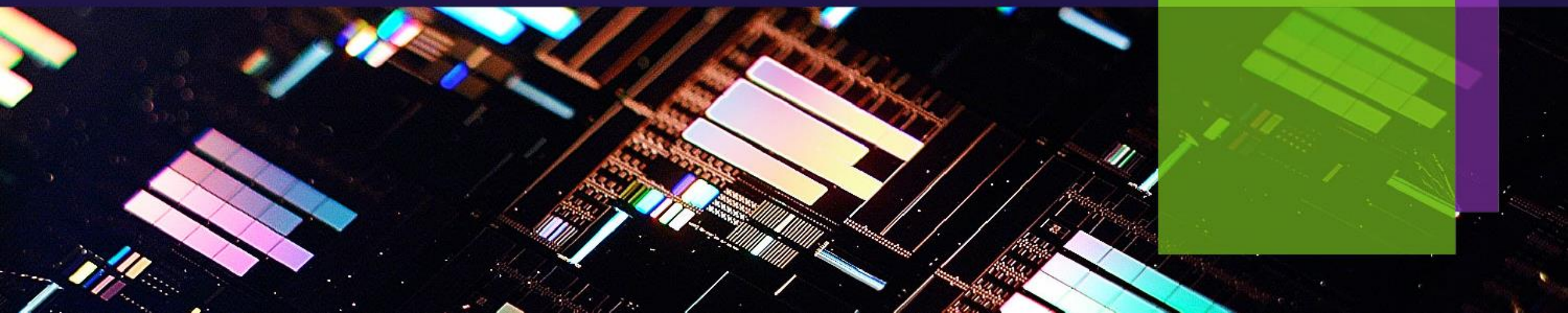


2024年3月期 第3四半期（2023年10月～12月） 東京エレクトロン 決算説明会

2024年2月9日

内容：

- 連結決算の概要 川本 弘 常務執行役員 ファイナンスユニットGM
- 事業環境および業績予想 河合 利樹 代表取締役社長・CEO



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、地政学的リスク、半導体市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスク、新型コロナウイルス感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

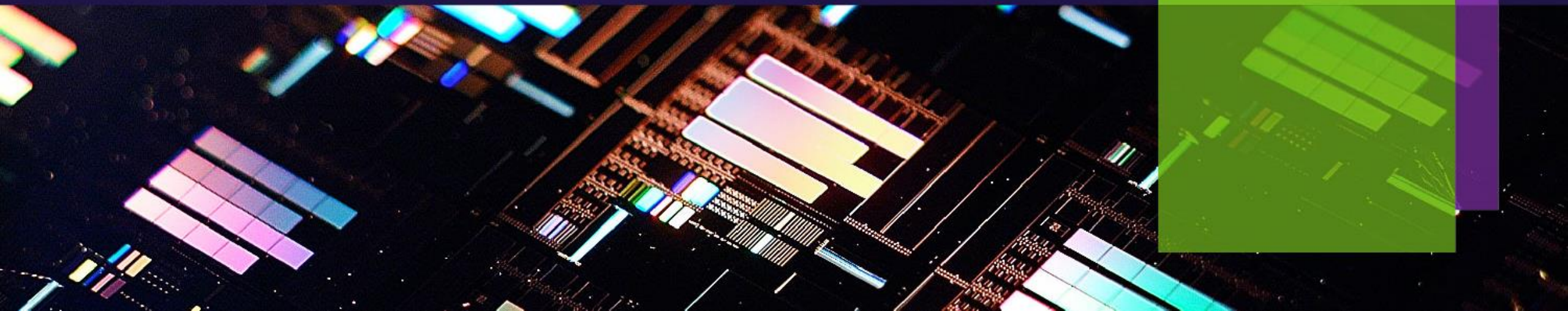
当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は極めて軽微です。



第3四半期 連結決算の概要

2024年2月9日

川本 弘
常務執行役員 ファイナンスユニットGM



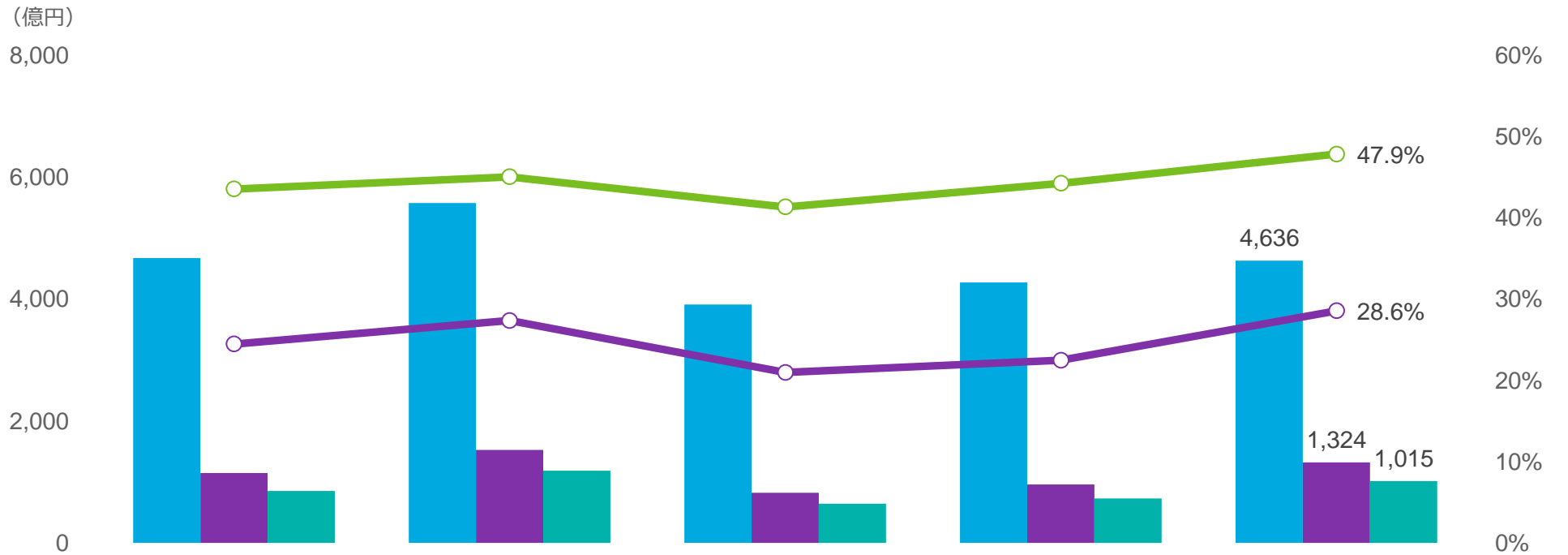
損益状況（四半期）

（億円）

	FY2023		FY2024			QoQ	YoY
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	vs. Q2 FY2024	vs. Q3 FY2023
売上高	4,678	5,582	3,917	4,278	4,636	+8.4%	-0.9%
売上総利益	2,039	2,516	1,623	1,897	2,221	+17.1%	+8.9%
売上総利益率	43.6%	45.1%	41.4%	44.3%	47.9%	+3.6pts	+4.3pts
販管費	891	989	798	935	896	-4.2%	+0.6%
営業利益	1,147	1,527	824	961	1,324	+37.8%	+15.4%
営業利益率	24.5%	27.4%	21.0%	22.5%	28.6%	+6.1pts	+4.1pts
税金等調整前当期純利益	1,163	1,556	830	981	1,344	+37.0%	+15.6%
親会社株主に帰属する当期純利益	855	1,186	643	731	1,015	+38.7%	+18.6%
研究開発費	461	537	436	510	497	-2.4%	+8.0%
設備投資額	125	263	393	176	318	+80.5%	+153.2%
減価償却費	112	120	106	125	138	+9.7%	+22.6%

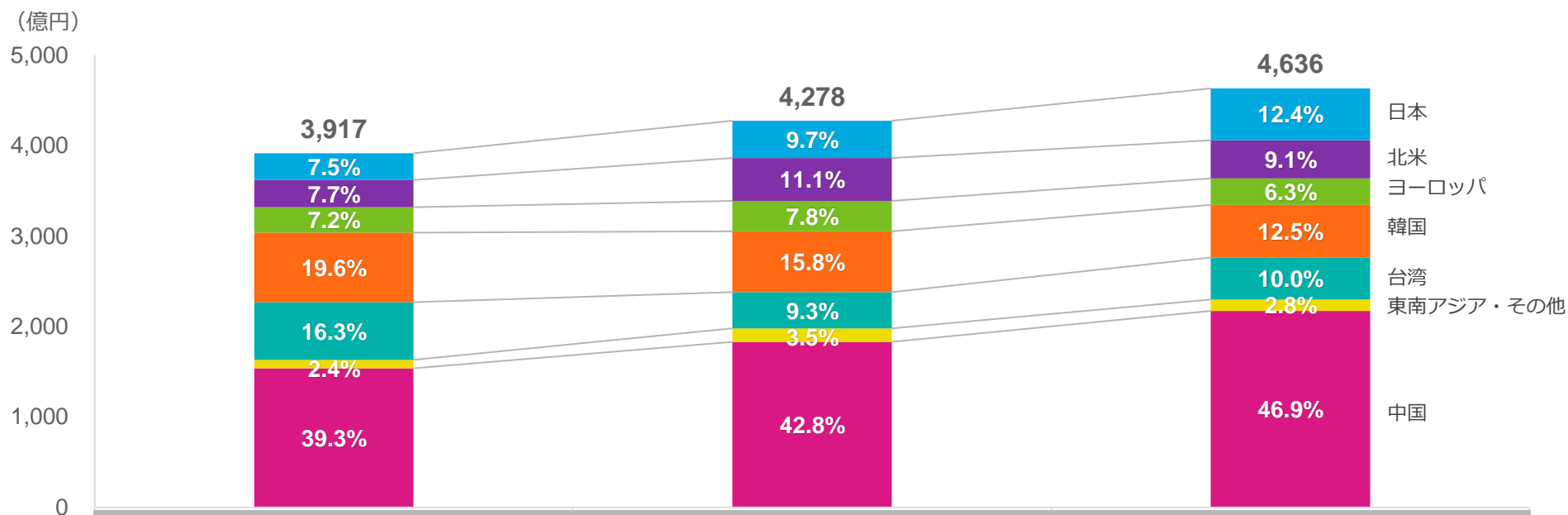
1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

損益状況（四半期）



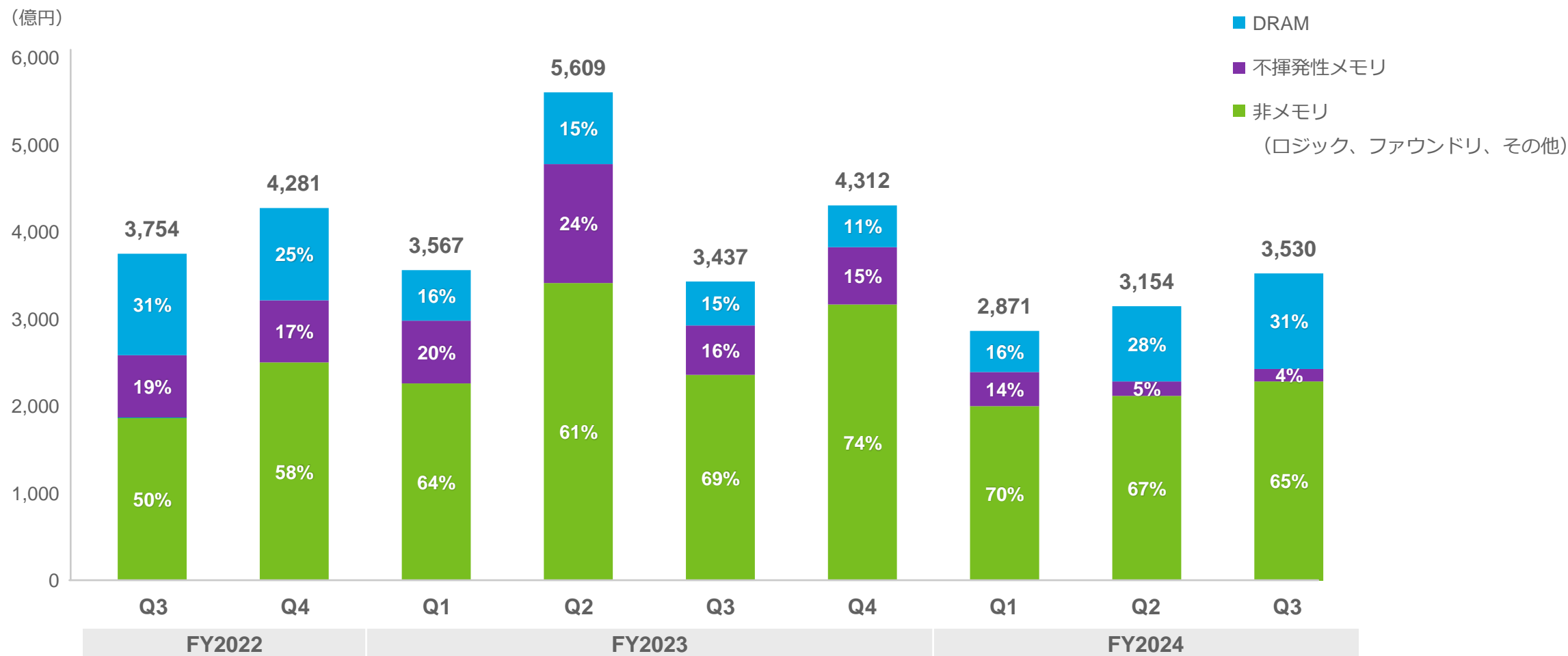
	FY2023		FY2024		
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
■ 売上高	4,678	5,582	3,917	4,278	4,636
■ 営業利益	1,147	1,527	824	961	1,324
■ 親会社株主に帰属する当期純利益	855	1,186	643	731	1,015
○ 売上総利益率	43.6%	45.1%	41.4%	44.3%	47.9%
○ 営業利益率	24.5%	27.4%	21.0%	22.5%	28.6%

地域別売上高構成比 (FY2024 Q1~Q3)



	FY2024		
	Q1	Q2	Q3
日本	295	412	574
北米	301	474	421
ヨーロッパ	281	335	294
韓国	767	674	582
台湾	639	399	463
東南アジア・その他	92	151	127
中国	1,539	1,829	2,172

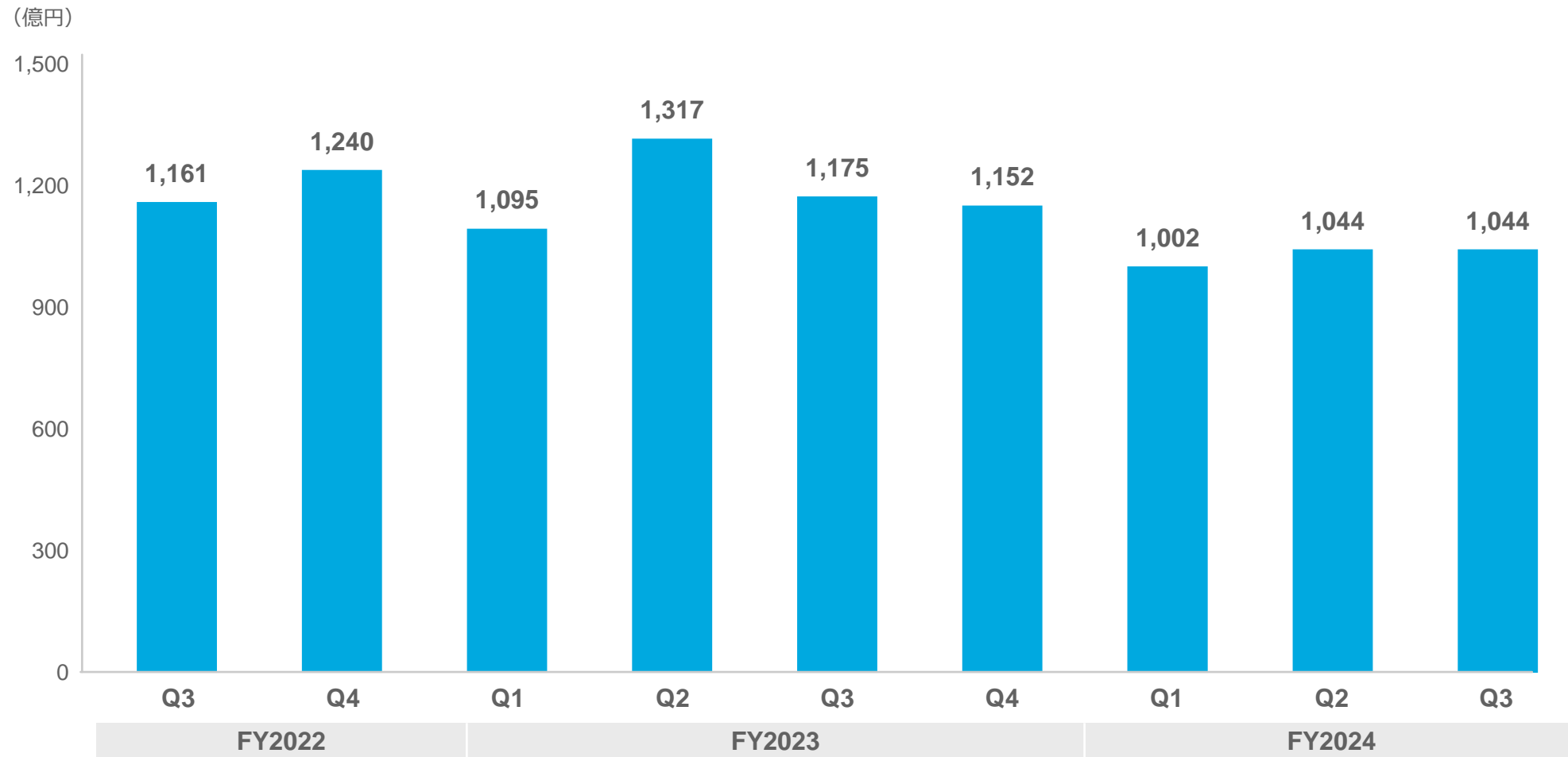
SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）



*1 SPE：半導体製造装置

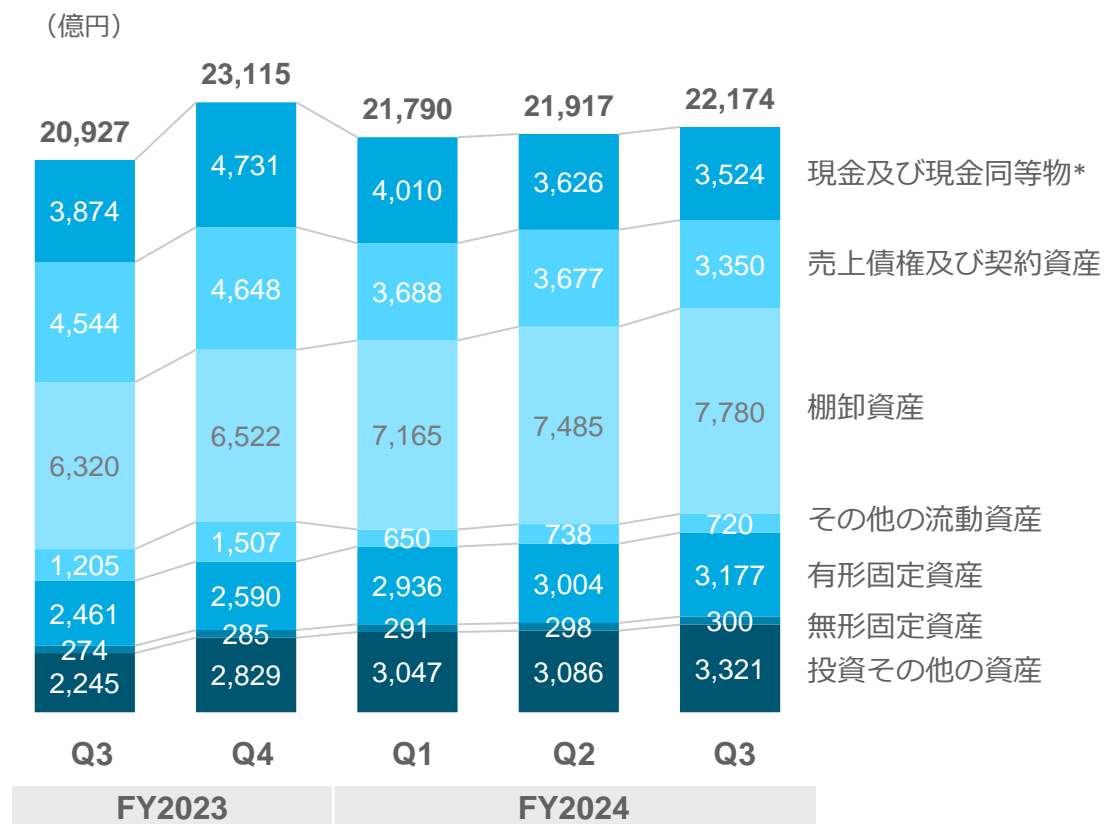
*2 グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません。

フィールドソリューション売上高（四半期）

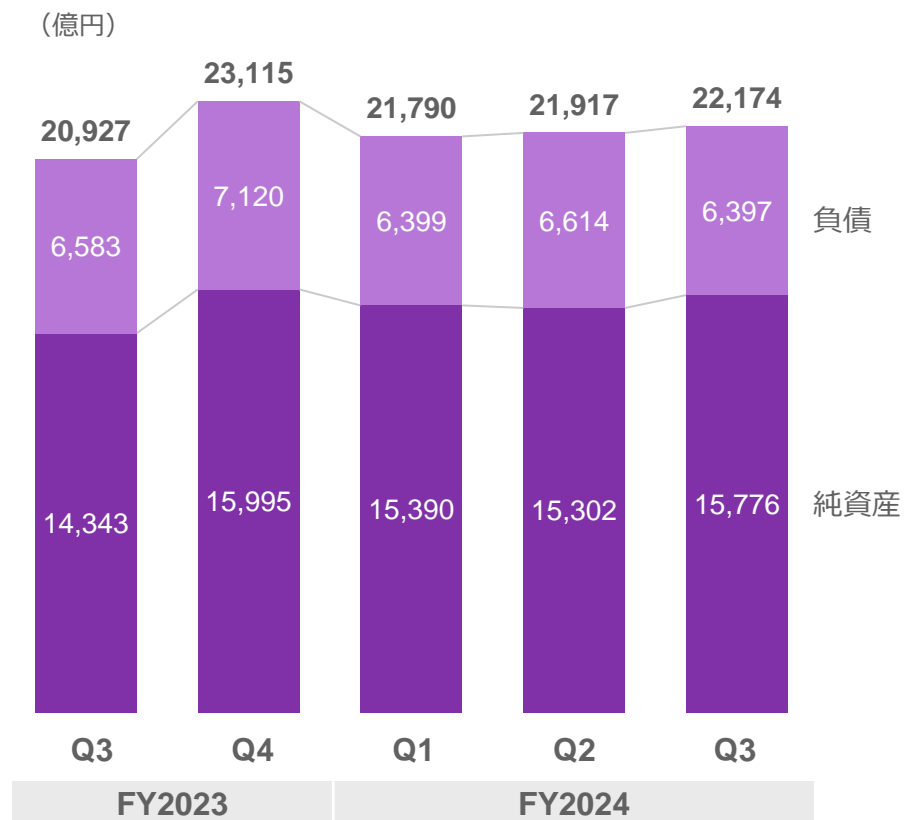


貸借対照表（四半期）

資産

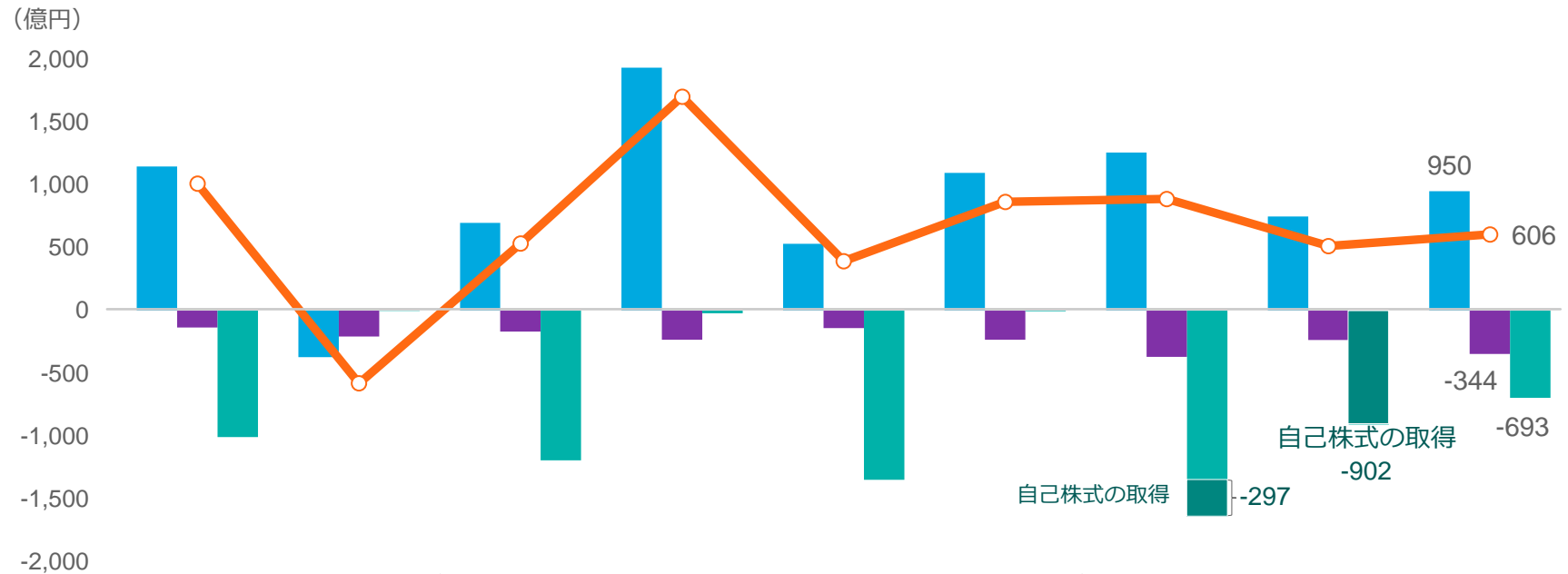


負債・純資産



*現金及び現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

キャッシュ・フロー（四半期）



	FY2022		FY2023				FY2024		
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
■ 営業キャッシュ・フロー	1,146	-371	699	1,934	532	1,096	1,257	748	950
■ 投資キャッシュ・フロー*1	-135	-207	-166	-231	-138	-231	-368	-234	-344
■ 財務キャッシュ・フロー	-1,007	-2	-1,191	-21	-1,346	-5	-1,641	-908	-693
○ フリーキャッシュ・フロー*2	1,010	-579	533	1,702	393	865	888	514	606
■ 手元資金残高*3	4,239	3,712	3,146	4,846	3,874	4,731	4,010	3,626	3,524

*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

*2 フリーキャッシュ・フロー=営業キャッシュ・フロー+投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）

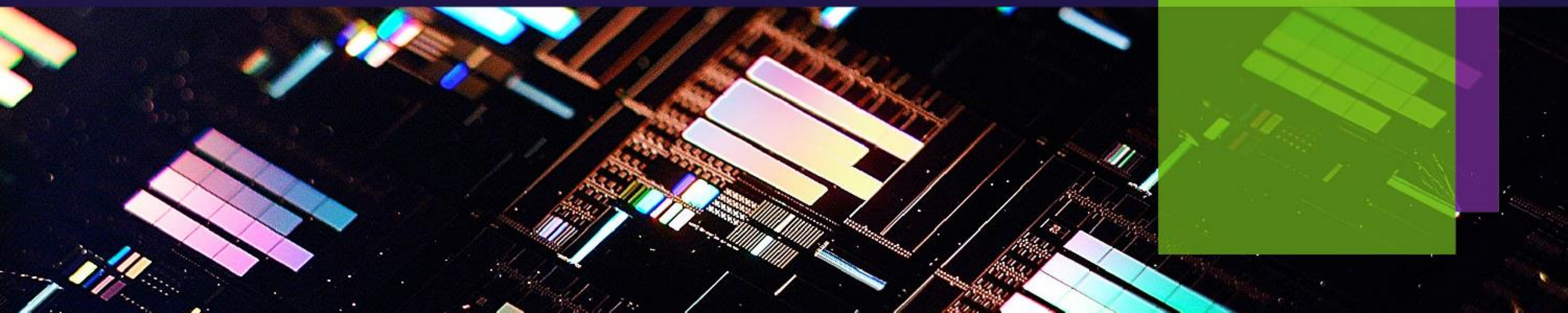
*3 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3か月を超える定期預金および短期投資の合計額です。



事業環境および業績予想

2024年2月9日

河合 利樹
代表取締役社長・CEO



事業環境（2024年2月時点でのWFE市場の見方）

■ **CY2023：\$95B程度で着地と試算**

- 中国顧客の投資増に伴い上方修正

■ **CY2024：\$100B程度と予測**

- 中国顧客の投資継続と、年後半の最先端DRAM向け投資の回復を見込む

■ **CY2025：二桁成長を期待**

- AIサーバーの成長が継続（CAGR 2023-2027：+31%*）
- PC・スマートフォンの需要回復
 - オンデバイスAIなど、新たなアプリケーションに対応した新機能
 - コロナ期に購入した製品の買い替え
 - 企業のIT投資

➔ これらに伴い、先行するDRAMに加え、NANDと先端ロジック/ファウンドリの設備投資も回復すると予測

*Source : Omdia

FY2024 Q3 事業進捗

- 売上・利益とも、順調に進捗
- 戦略製品によるPOR^{*1}獲得や、将来成長に向けた開発評価が進展
 - POR獲得：DRAM向け HARC^{*2}エッチング、先端ロジック向けSiエッチング、先端ロジック向け裏面ベベル洗浄
 - 極低温エッチングの量産に向けた評価も順調
 - ウェーハボンディング/デボンディング装置：量産受注が急拡大し、想定の2倍以上の引き合い
- 半導体の技術革新に貢献する新技術・新製品をリリース
 - レーザ剥離技術：薄化工程の歩留まりを改善。環境負荷を大幅に低減するブレイクスルー技術
 - ウェーハ薄化装置 Ulucus™ G：当社独自の技術を活用し、EUVや高密度三次元実装等を適用した最先端デバイスに求められるウェーハの超平坦化を実現。半導体の技術革新を推進しWFE市場の成長を後押し
- ネットゼロ達成目標年を10年前倒し、CY2040に

*1 POR: Process of Record

*2 HARC: High aspect ratio contact

FY2024 業績予想

FY2024 業績予想

(億円)

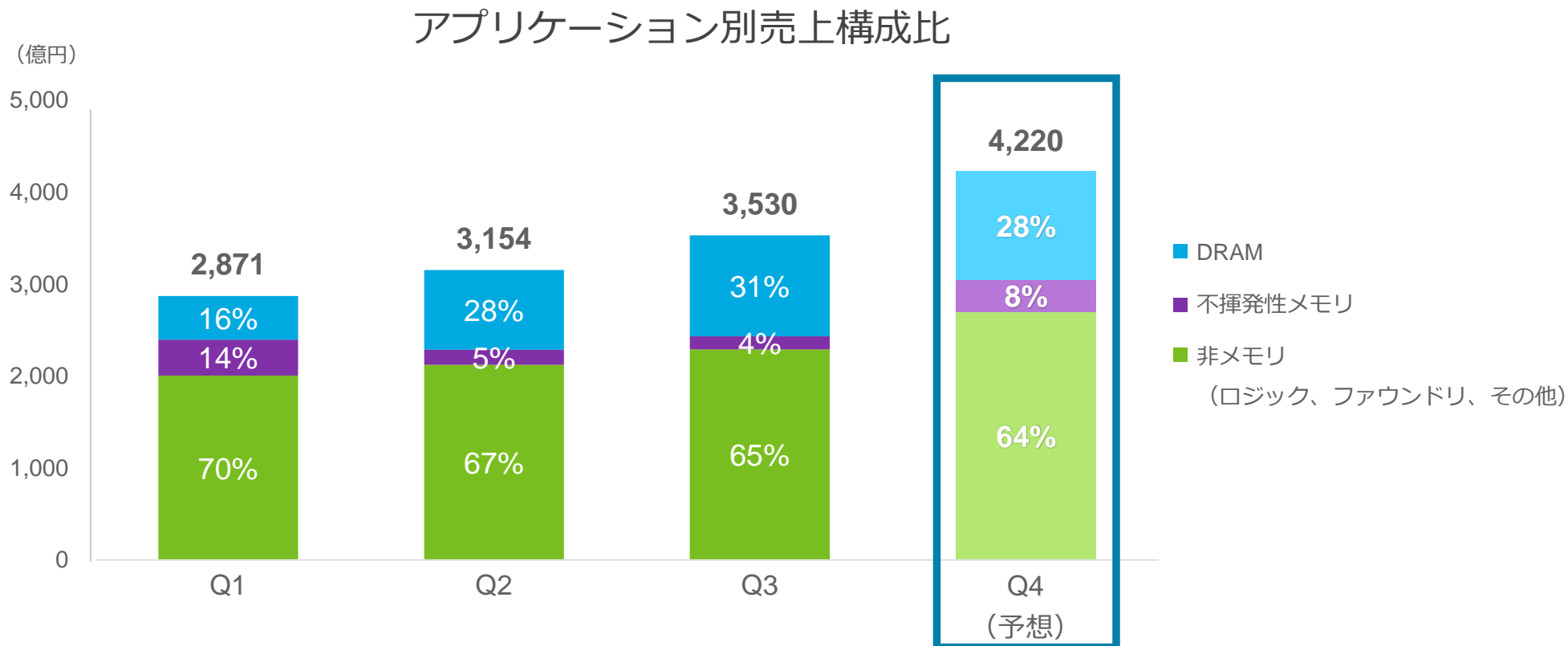
	FY2023 (実績)	FY2024			
		実績	新予想		修正額*1
		H1	H2	通期	通期
売上高	22,090	8,195	10,104	18,300	+1,000
売上総利益 売上総利益率	9,844 44.6%	3,520 43.0%	4,649 46.0%	8,170 44.6%	+540 +0.5pts
販管費	3,666	1,734	1,985	3,720	+100
研究開発費	1,911	946	1,103	2,050	+0
研究開発費以外の販管費	1,754	787	882	1,670	+100
営業利益 営業利益率	6,177 28.0%	1,785 21.8%	2,664 26.4%	4,450 24.3%	+440 +1.1pts
税金等調整前当期純利益	6,248	1,811	2,688	4,500	+460
親会社株主に帰属する当期純利益	4,715	1,374	2,025	3,400	+330
1株当たり当期純利益 (円) *2	1,007.82	295.13	-	732.16	+71.02

*1 2023年11月10日に発表した業績予想からの修正額を示しています。

*2 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しています。前連結会計年度の期首に当該株式分割がおこなわれたと仮定して、「1株当たり当期純利益」を算定しています。

Q3実績およびQ4見通しを反映し、業績予想を修正

FY2024 SPE新規装置売上予想



グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高は含まれていません。

新規装置の売上は回復基調に

FY2024 研究開発費・設備投資計画

新開発棟

成膜装置、エッチング装置、コーポレート開発



山梨県斐崎市
2023年7月 竣工

東北生産・物流センター

成膜装置



岩手県奥州市
2025年秋 竣工予定

新開発棟

コータ/デベロッパ、洗浄装置



熊本県合志市
2025年夏 竣工予定

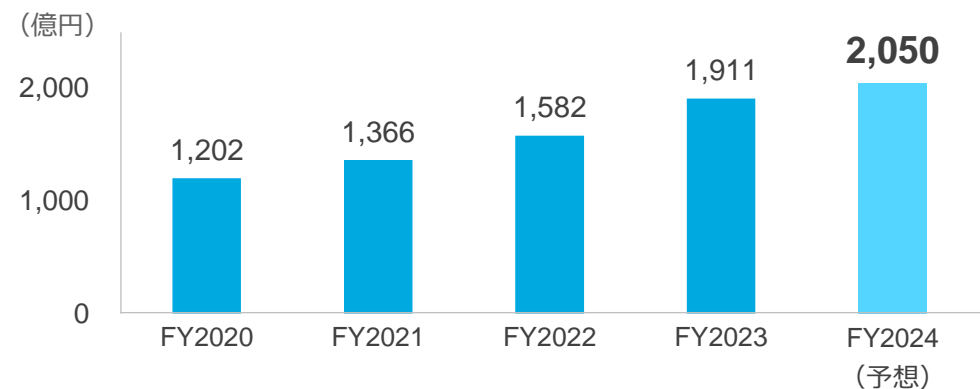
新開発棟

エッチング装置

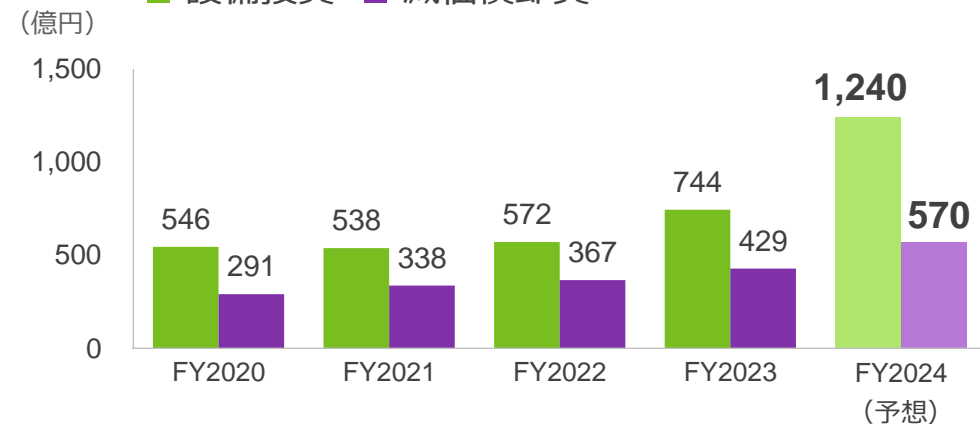


宮城県黒川郡
2025年春 竣工予定

■ 研究開発費

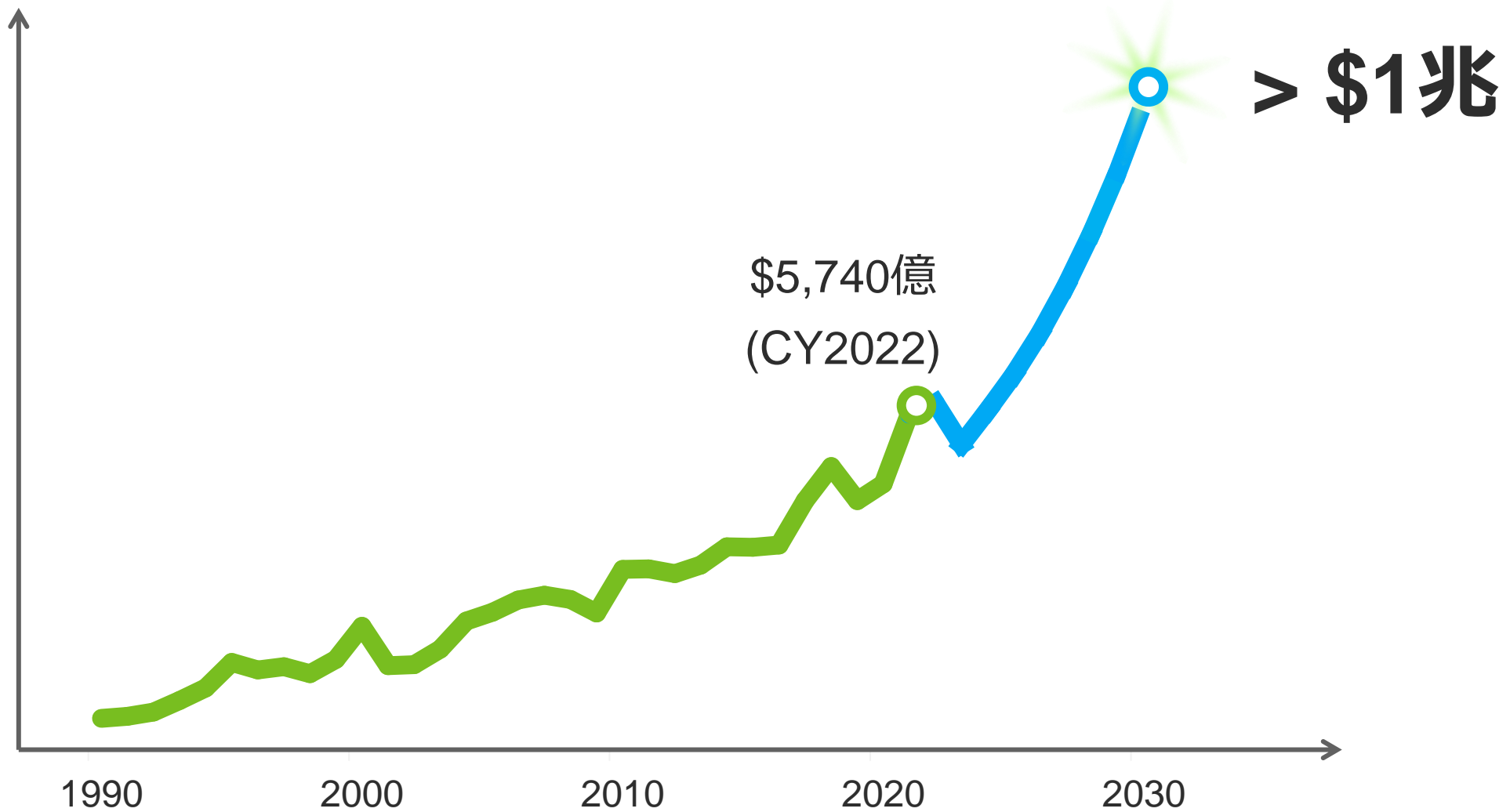


■ 設備投資 ■ 減価償却費



持続的成長を見据え、積極的な研究開発・設備投資を継続

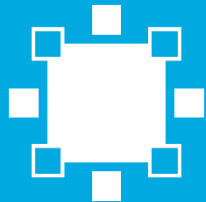
半導体市場はCY2030には\$1兆に



未来に向けた成長投資（FY2025～FY2029）

研究開発費

1.5兆円



設備投資

7,000億円



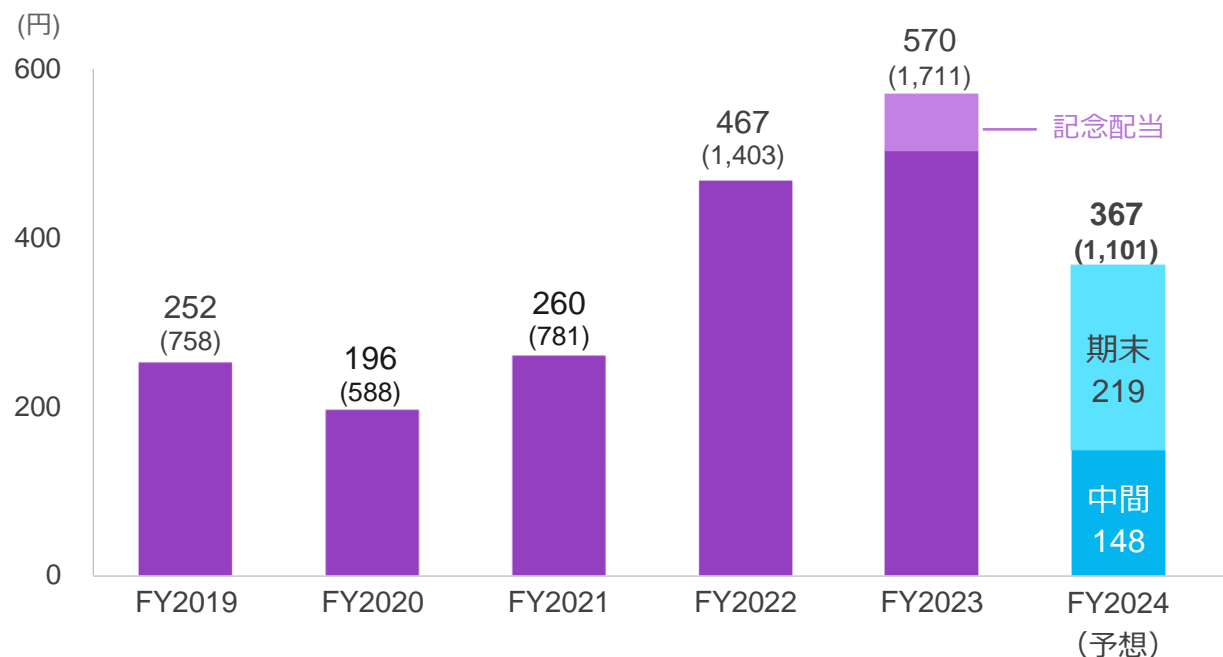
人材採用

10,000人
毎年2,000人



FY2024 配当予想

1株当たり配当金



当社の株主還元策

連結配当性向：50%

但し、1株当たり年間配当金50円*を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

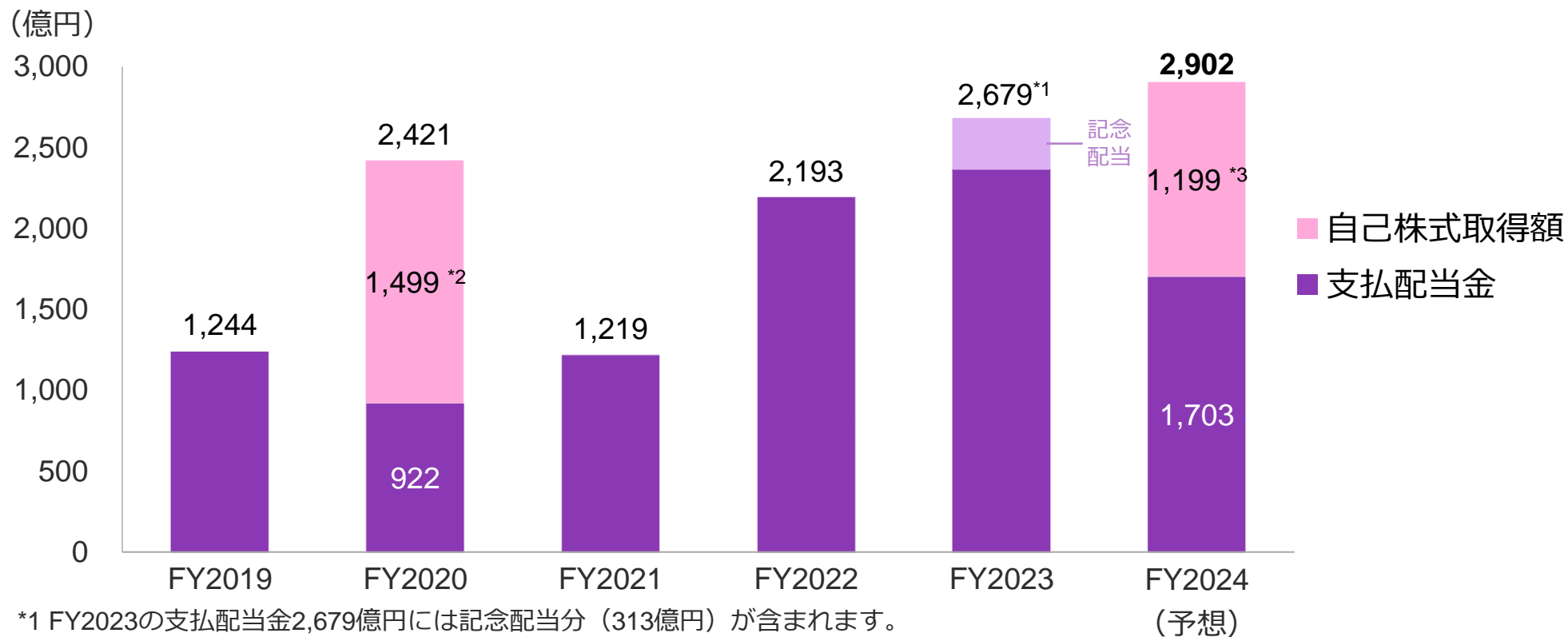
自己株式の取得：機動的に実施を検討

*2023年4月1日付の株式分割により、従来の150円から変更しています。

- FY2019～2023の1株当たり配当額は、FY2019の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しています。
- FY2023には60周年記念配当が含まれます。
- 株式分割がおこなわれる以前の金額を（ ）内で記載しています。

2023年4月1日付で普通株式1株を3株に分割。通期配当は367円を予定

総還元額



*1 FY2023の支払配当金2,679億円には記念配当分（313億円）が含まれます。

*2 https://www.tel.co.jp/news/ir/2020/20200106_001.html

*3 https://www.tel.co.jp/news/ir/2023/sb15um000000009e-att/20231002_001.pdf

自己株式取得と合わせ、過去最高の総還元額を見込む

TEL | 60[↑] years